

贴片用红胶工艺

生成日期: 2025-10-28

SMT贴片红胶的工艺方式:

- 1) 印刷方式: 钢网刻孔要根据零件的类型, 基材的性能来决定, 其厚度和孔的大小及形状。其优点是速度快、效率高。
- 2) 点胶方式: 点胶是利用压缩空气, 将红胶透过特用点胶头点到基板上, 胶点的大小、多少、由时间、压力管直径等参数来控制, 点胶机具有灵活的功能。对于不同的零件, 我们可以使用不同的点胶头, 设定参数来改变, 也可以改变胶点的形状和数量, 以求达到效果, 优点是方便、灵活、稳定。缺点是易有拉丝和气泡等。我们可以对作业参数、速度、时间、气压、温度调整, 来尽量减少这些缺点。
- 3) 针转方式, 是将一个特制的针膜, 浸入浅胶盘中每个针头有一个胶点, 当胶点接触基板时, 就会脱离针头, 胶量可以借着针的形状和直径大小来变化。固化温度 100℃ 120℃ 150℃ 固化时间 5分钟 150秒 60秒 典型固化条件:

注意点: 1、固化温度越高以及固化时间越长, 粘接强度也越强。

2、由于贴片胶的温度会随着基板零件的大小和贴装位置的不同而变化, 因此我们建议找出较合适的硬化条件。

红胶的储存: 在室温下可储存7天, 在小于5℃时储存大于6个月, 在5~25℃可储存大于30天

□SMT贴片红胶的使用方法。贴片用红胶工艺

什么是SMT贴片红胶□SMT红胶是单组份加热固化型环氧树脂胶粘剂, 又名红胶、贴片红胶、贴片胶, 分为刮胶和点胶两种。其容许低温固化, 超高速微量涂敷仍可保持没有拉丝、溢胶、塌陷的稳定形状, 其“剪切稀化”粘度特性和低吸湿性, 适合应用于SMT红胶工艺, 储存稳定且具有良好的耐热冲击性能和电气性能。红胶具有粘度流动性, 温度特性, 润湿特性等。红胶的应用:

1□SMT贴片加工中电子元器件的黏接固定;

2、电子产品部分位置的固定粘接及作标志等。贴片用红胶工艺SMT贴片红胶回温要求在室温下回温4小时, 按先进先出的顺序使用。

红胶过回流焊固化后, 如产生贴装元件浮高, 可能是由于:

- (1) 升温速率过快, 红胶膨胀过度;
- (2) 红胶中气泡太多;
- (3) 贴装元件时, 贴片位置设置不当。

1、参考IPC610C标准, 一切以客户标准为准, 客户“满意”是较终标准;

2、胶水质量: 使用及保管(在冰箱保管, 记得好像0~4度, 查胶水说明, 没有问供应商要)要注意, 受潮后回流过程气化容易导致元件偏移浮高; 胶水量, 太多就不好控制了; 回流曲线, 参考胶水回流的要求, 没有问供应商要, 供应商没有那胶水就太次了, 不是专业做的;

3、炉温设置同上面, 另外回流风速也有影响, 主要对于元件偏移, 浮高的影响没有测试过, 另外注意100度前的恒温, 个人认为受潮水的气化会有影响, 加长100度前的恒温时间, 减少水份剧烈气化时的影响; 建议采用缓慢升温-恒温-固化-冷却曲线。

SMT贴片加工的流程有哪些? 随着生产设备不断提高□SMT贴装技术越来越完善, 同时SMT贴片还具有高频特性好、电子产品体积小、高性能等优势, 使其逐渐发展成电子组装行业中较流的一种技术□SMT贴片加工

作为高精密的加工行业，物料采购加工/来料检测：采购团队根据客户发来的BOM清单进行采购，采购完后进行物料检验加工，或由客户提供贴装物料，收到物料后进行检测，确认无误后进行加工。丝印：丝印是SMT贴片加工的第1道工序，主要是把锡膏或贴片胶漏印到PCB焊盘上，为元器件焊接做准备。再通过锡膏印刷机，将锡膏渗透到不锈钢或镍制钢网附着到焊盘上□SMT贴片红胶固化温度是多少？

SMT红胶印刷速度：

SMT红胶印刷时期，刮板在印刷模具板上的挺进速度是很重要的，因为SMT红胶需要时间来骨碌和流入模孔内。如果时间不敷，那末在刮板的挺进标的目的□SMT红胶在焊盘大将不服。当速度高于每秒20 mm 时，刮板有可能在少于几十毫秒的时间内塑胶模具设计知识刮过小的模孔。

SMT红胶印刷压力：

印刷压力须与刮板硬度协调，如果压力过小，刮板将刮不洁净模具板上的锡膏，如果压力太大，或刮板太软，那末刮板将沉入模具板上较大的孔内将SMT红胶挖出。

压力的经验公式：

在金属模具板上施用刮板，为了获患上不错的压力，起头时在每50 mm的刮板长度上施加1 kg 压力，例如300 mm 的刮板施加6 kg 的压力，慢慢削降低压力力直至SMT红胶起头留在模具板上刮不洁净，然后再增长1 kg 压力。在SMT红胶刮不洁净起头到刮板沉入丝孔内挖出SMT贴片红胶之间，应该有1~2 kg的可接管规模均可以达到好的丝印效验□SMT贴片红胶均匀分布于固化剂、颜料、溶剂等粘合剂中。贴片用红胶工艺

SMT贴片红胶是一种聚稀化合物。贴片用红胶工艺

SMT贴片红胶粘剂的用途：

- ①防止在波峰焊（波峰焊过程）中掉落组件。当使用波峰焊时，为了防止组件在印刷电路板穿过焊锡罐时掉落，请将这些组件固定在印刷板上。
- ②防止在回流焊（双面回流焊过程）中另一侧的组件掉落。在双面回流焊接过程中，为了防止焊接侧的大型设备因焊料的热量和熔化而掉落，应使用SMT贴片胶。
- ③防止零件移位和站立（回流焊接，预涂工序）。用于回流焊接工艺和预涂工艺，以防止在安装过程中移位和竖立。
- ④标记（波峰焊，回流焊，预涂）。此外，当更改一批印刷电路板和组件时，请使用SMD胶进行标记。贴片用红胶工艺